

第13世代intel CPU及び最新GPU RTX™ 4000 Ada SFF搭載、 画像処理・マシンビジョン・エッジAI向けのコンパクトな産業用PC

GPU搭載エッジサーバー
IPC-R670EI-Mini

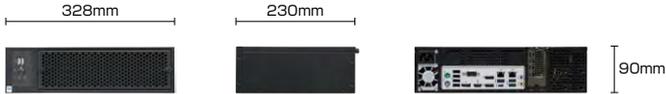
- 第13世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- 長期供給可能なインテル® Q670Eチップセット装備
- W328mm×H90mm×D230mmのコンパクトな筐体
- NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada搭載可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



■製品仕様

モデル	IPC-R670EI-Mini	
プロセッサ	種類	第13世代 インテル® Core™ プロセッサ(TDP65W)
	搭載数	1
チップセット	インテル® Q670Eチップセット	
メモリ	規格	DDR5-4800 nECC SO-DIMM
	容量	標準32GB (16GB×2) ※最大64GB (32GB×2)
	スロット数	2
ストレージ	5インチベイ	無し
	3.5インチベイ	無し
	2.5インチベイ	シャドウベイ 2
GPU	NVIDIA RTX™ 4000 Ada SFF	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
I/O	PS/2	1 (キーボード) 1 (マウス)
	HDMI	1
	DisplayPort	3
	DVI-D	無し
	VGA	無し
	COM	1 (RS232/422/485)
	USB	前面 2 (USB3.2 Gen1 TypeA) 背面 2 (USB3.2 Gen2 TypeA), 1 (USB3.2 Gen2 TypeC), 4 (USB2.0)
	LAN	1 (2.5GbE) 1 (1GbE)
	IPMI	無し
	Audio	背面 2 (Line-in, Line-out)
拡張スロット	Intel® 13th Gen Processors 1 x PCIe 5.0 x16 slots	
外形寸法	W328mm×H90mm×D230mm(突起物等を除く)	
重量	約4.6kg	
電源	ニプロン電源 245W (連続最大容量)/346W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)

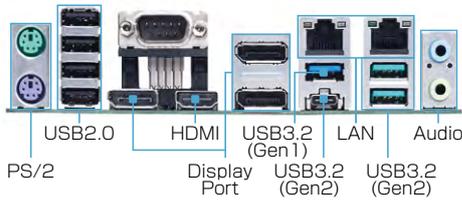
■外形寸法



■拡張スロット

PCI Express x16 (CPU)
Gen 5.0, x16 シングナル

■I/Oポート



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間: 9:00~18:00 (土日、祝日、年末年始を除く)

TEL: 03-5446-5535 mail: cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト: <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2024年3月現在の内容です。